

电子行业周报 (4.01-4.07)

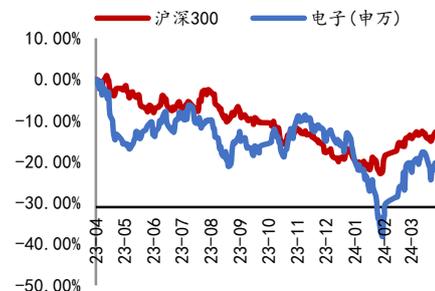
台湾花莲地震，关注电子行业供应链安全

强于大市(维持评级)

投资要点:

- 4月3日，中国台湾省花莲县东部海域发生7.3级地震，系近25年来最大规模地震。台湾囊括了半导体、面板、被动元器件、电子组装等各个领域的尖端制造，其晶圆代工产业在全球占了64%的份额，是世界最大的晶圆生产基地，先进制程更是处于垄断地位。而精密的半导体制造对生产稳定性要求极高，故本次地震对全球电子供应链可能会产生一定的扰动。
- 晶圆代工方面**，台积电指出，其产能在震后十小时恢复到了7/8成，且关键设备EUV无虞，但部分N3制程晶圆厂出现横梁断裂、管道损坏等情况，且部分振幅较大地区生产线需要较长时间的调整和校正。同时，联电、世界先进、力积电等晶圆厂均受到一定程度的影响，当前多处于部分停机和影响评估的环节中。整体来看，晶圆代工产能正陆续恢复，且相关供应和支援维持正常水平，但考虑到先进封装、GPU/AI芯片等目前面临供应瓶颈，故而短期内可能对相关行业供需造成一定影响。**存储方面**，靠近震中的新竹、台中和桃园占据了69%的产能，部分存储厂商正进行预防性停机检查和设备调试。其中，由于美光的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此该公司率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。而三星、SK海力士也跟进停止报价，希望观望后市后再行动。**除此之外**，被动元器件、半导体材料、面板等电子产业均受到不同程度的影响，而地震造成的停产和检修可能带来一定价格扰动和订单转移。
- 从中短期角度来看**，由于花莲县距离电子产业集中的台湾西部地区有一定距离，故本次地震对大多电子厂商的直接物理破坏相对较小。但即便如此，本次地震带来的冲击仍不容小觑，首先，半导体行业是极其精密的制造行业，对自然环境的稳定性、电力能源、环境的洁净度等方面有极高要求，故大多厂商在短期内面临着厂务和设备的维护检修工作；其次，台湾半导体供应链遍布全球，地震可能影响台厂的原材料运输和产品出货；另外，地震引发的次生灾难也可能对供应链的稳定和安全产生影响。进一步的，当前半导体产业链去库存周期或进入尾声，台积电此前表示行业库存已恢复健康，且部分领域已有扩产规划，而此番遭遇地震可能间接影响到GPU、AI芯片、存储芯片等产品的价格。**从更长期的角度来看**，半导体产业作为现代科技的基石，其稳定性和连续性至关重要，而台湾作为全球半导体产业链中不可或缺的一环，本次地震对于对半导体行业产生的连锁反应不可忽视。同时，从此次事件我们可以看出，半导体供应链的多样性和韧性至关重要，因此，国内厂商产品的攻关与替代，对应此类不可抗突发事件的发生、以及维护全球电子产业的持续稳定发展，具有长远的战略性意义。
- 投资建议**：半导体方向，建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，如**昌红科技、新莱应材、正帆科技、汉钟精机、腾景科技、英杰电气、苏大维格**等，以及IC封装领域重点公司，如**长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技**等。AI应用终端方向，建议关注**华勤技术、福蓉科技、胜宏科技、飞荣达、通富微电、龙芯中科、TCL科技、京东方、伟时电子、龙腾光电、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达、广信材料**等。
- 风险提示**：技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；电子行业景气复苏不及预期。

一年内行业相对大盘走势



电子行业估值 (PE)



团队成员

分析师 杨钟
 执业证书编号: S0210522110003
 邮箱: yz3979@hfzq.com.cn

相关报告

- 《华为“三折”专利公布，折叠市场焕发新春》——2024.03.31
- 《SEMICON CHINA圆满落幕，半导体行业春意盎然》——2024.03.25
- 《AI芯片最强辅助，HBM进入黄金时代》——2024.03.18

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	6
2.1	半导体板块.....	6
2.2	AI 板块.....	8
2.3	消费电子板块.....	8
2.4	汽车电子板块.....	9
2.5	面板板块.....	10
三、	公司动态跟踪.....	11
四、	风险提示.....	12

图表目录

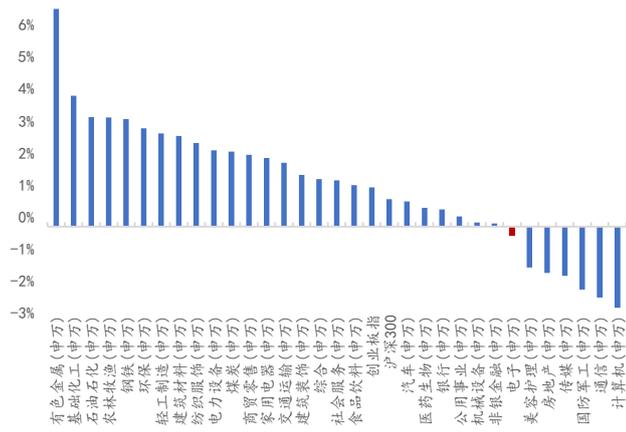
图表 1:	SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2:	电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3:	电子细分领域本周涨跌幅 (%)	3
图表 4:	SW 电子本周涨幅前十个股 (%)	4
图表 5:	SW 电子本周跌幅前十个股 (%)	4
图表 6:	SW 电子本周换手率前二十个股 (%)	4
图表 7:	SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 8:	SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 9:	过去一周股东增减持更新	11
图表 10:	过去一周股权激励一览.....	12

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

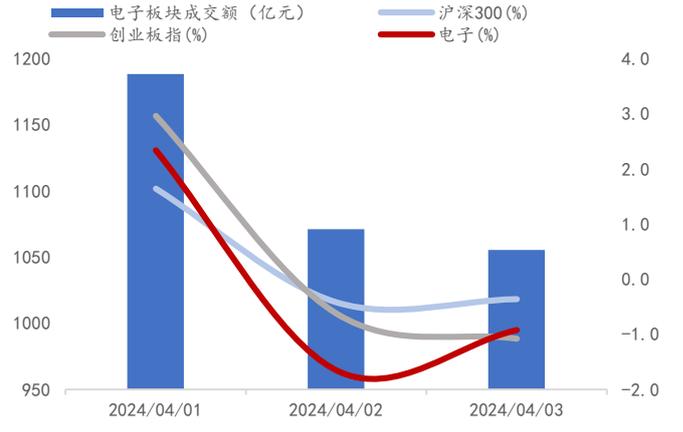
大盘表现上，本周（0401-0403）创业板指数上涨 1.22%，沪深 300 指数上涨 0.86%。本周电子行业指数下降 0.28%，行业表现上，电子行业位列全行业的第 25 位，本周有色金属、基础化工、石油石化板块涨幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

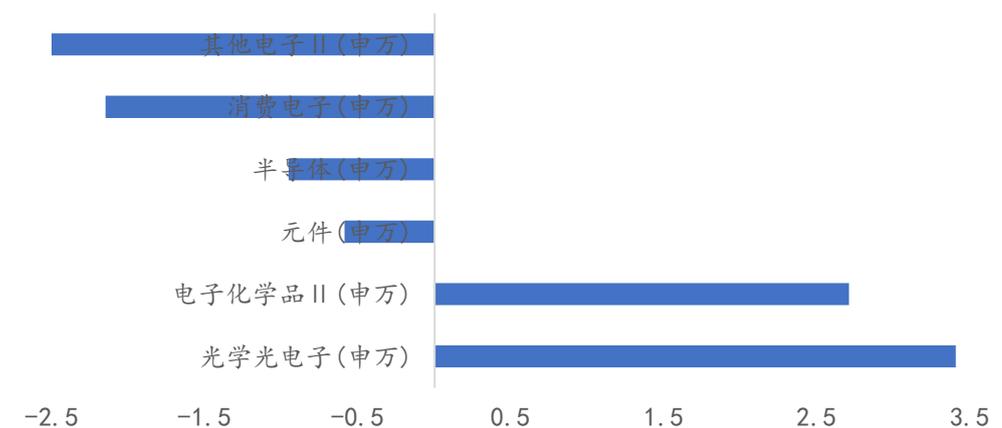
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周其他电子、消费电子、半导体、电子化学品、元件板块出现分化，具体来看，光学光电子板块升幅较大，周涨跌幅为 3.41%，其次为电子化学品板块，周涨跌幅为 2.71%。其他电子板块跌幅最大，周涨跌幅为-2.51%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅 (%)

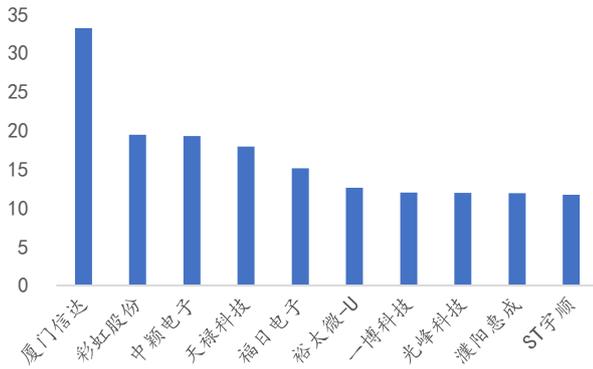


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

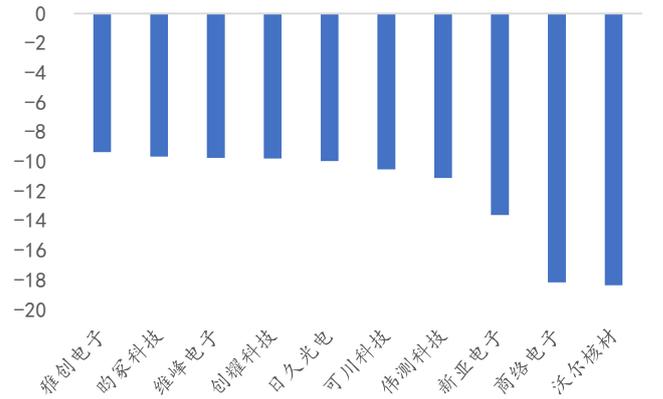
从个股维度来看，SW 电子板块中，厦门信达 (33.21%)、彩虹股份 (19.46%) 等位列涨幅前列；沃尔核材 (-18.37%)、商络电子 (-18.18%) 等位列跌幅前列。

图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

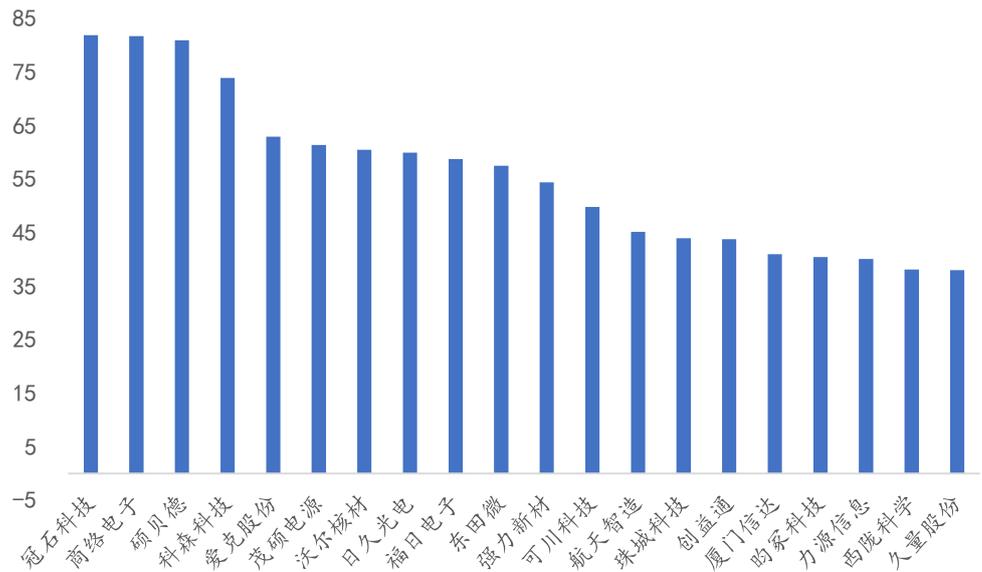
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是冠石科技,换手率为 81.83%。其余换手率较高的还有商络电子(81.64%)、硕贝德(80.86%)和科森科技(73.85%)。

图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)

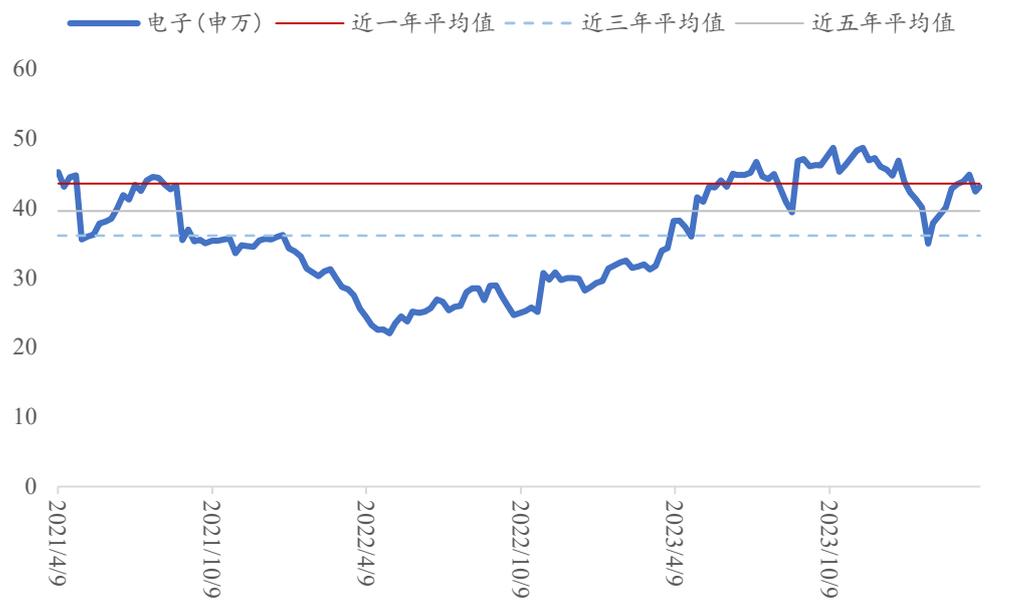


数据来源: Wind, 华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值高于三年、五年平均值水平,低于近一年平均值水平。本周 PE (TTM) 为 43.06 倍,较上周继续下调。

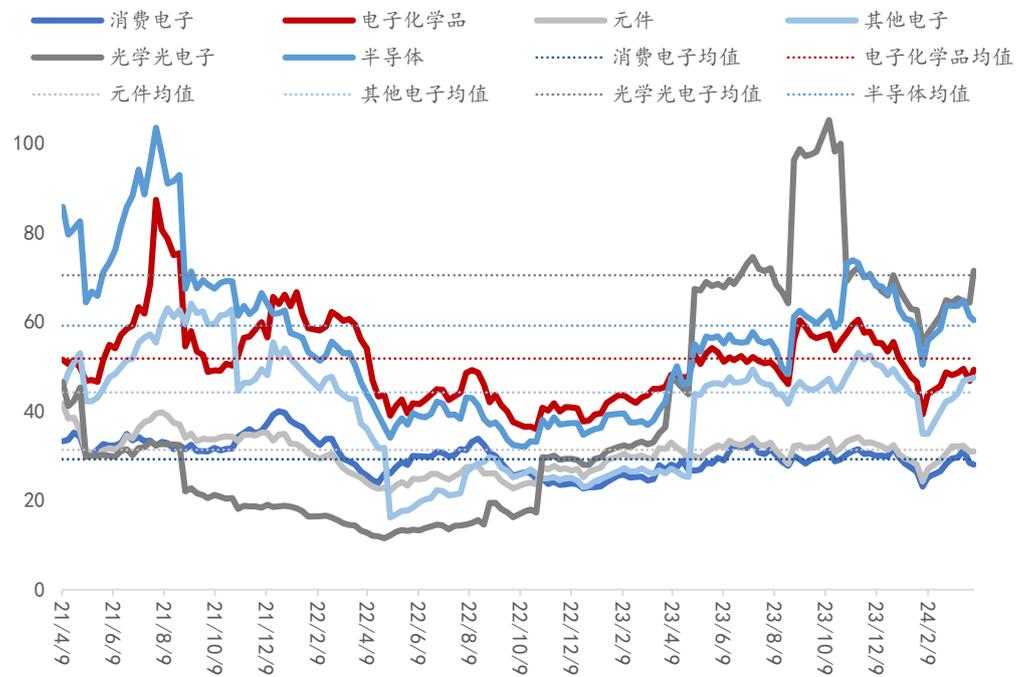
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 近一年消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 均值分别为 29.20、51.75、31.30、44.15、70.40 和 59.13。除消费电子和半导体板块外, 本周其他电子细分板块估值均有一定程度上升, 其中光学光电子 PE 涨幅较大。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、 行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 机构：中国台湾地震将对半导体行业产生短期影响

4月3日，中国台湾遭受25年来最大规模地震，研究机构TechInsights认为考虑到震中位于东海岸，半导体行业受到的影响似乎较小。

中国台湾先进逻辑芯片产能集中在台南、台中和新竹。台南拥有其中58%的产能，由于距离震中较远，受地震影响最小。但是新竹和台中距震中相对较近，可能面临更大的影响。这两个地点总共代表超过200 kspwm的前沿产能，可能会受到地震的影响。

该机构表示，在内存方面，新竹、台中和桃园占据了69%的产能。由于靠近震中，它们被破坏的风险最高。由于美光超过60%的DRAM产能位于台中和桃园，该公司的风险敞口相当大。

虽然地震后部分公司进行设备停产，但由于中国台湾的生产基地在设计时就考虑到抗震能力，半导体先进制造使用的设备也设有保护装置，因此TechInsights预计此次地震对半导体行业的影响很小（除非发生变化）。鉴于目前已知的情况，将看到一些短期供应中断，这可能会被高库存水平所缓冲。存储行业可能会看到更多的提升，特别是在供应相对受限的领域。

2) 三星组建HBM产能质量提升团队，加速AI推理芯片Mach-2开发

4月1日消息，三星电子DS部门负责人庆桂显近日在社交媒体上表示三星内部正采取双轨AI半导体策略，同步提高在AI用存储芯片和AI算力芯片领域的竞争力。

在AI用存储芯片部分，三星组建了由DRAM产品与技术负责人Hwang Sang-joon领导HBM内存产能与质量提升团队，这是其今年建立的第二个HBM专门团队。

三星近期在HBM内存上进行了大规模的人才投入，旨在赢回因策略失误而被SK海力士拿下的HBM内存市场领军地位：2019年，三星因对未来市场的错误预测，解散了当时的HBM研发团队。

3) 三星涨价25%!

4月1日消息，据媒体报道，三星电子今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%！原本，三星电子计划的价格上调幅度是15%，但显然市场需求的增长超出了预期，因此价格上调幅度有所扩大。

与此同时，根据调研机构TrendForce的报告，消费级SSD的价格也预计将再次上涨，涨幅预计在10-15%之间。这一趋势的形成，主要是由于上游减产影响的持续，以及供应商库存水平的下降。尽管第二季度的NAND闪存采购量略低于一季度，但闪存合约价依然有望继续上涨。

4) 台积电日本二厂也将落脚熊本菊阳町，预计今年年底动工

台积电方面表明，计划在日本熊本县兴建的第二工厂，将跟第一工厂一样位于菊阳町。台积电总裁魏哲家跟日本首相岸田文雄等人会谈时，作上述表示。台积电位于日本的第二工厂预计 2024 年底动工，2027 年底开始量产。目前研判第二工厂的位置将会靠近预计今年年底量产的第一工厂。

日本官员希望台积电的到来将有助于推动当地供应商的技术和业务。日本已拨款 4760 亿日元（合 31 亿美元）用于台积电的第一座工厂，该工厂是由台积电与索尼集团等当地公司成立的合资企业建造的。日本政府已承诺为台积电额外提供 7320 亿日元的补贴，以建设第二工厂。

5) SIA：全球半导体行业销售 462 亿美元 我国芯片销售同比大增 28.8%

美国半导体行业协会 (SIA) 宣布，2024 年 2 月全球半导体行业销售额总计 462 亿美元，较去年同期增长 16.3%，但较之 2024 年 1 月的 476 亿美元下降 3.1%。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，虽然环比销售额略有下降，但 2 月份全球半导体销售额仍远远领先于去年同月的总额，延续了市场自去年中期以来的强劲同比增长势头，预计今年市场将持续增长。

6) SK 海力士宣布：斥资约 40 亿美元在美建 HBM 先进封装厂

韩国存储芯片大厂 SK 海力士计划斥资 38.7 亿美元在印第安纳州兴建先进封装厂和人工智能产品研究中心。

SK 海力士表示，将在美国印第安纳州西拉法叶市建造其首个美国先进封装厂，计划于 2028 年下半年开始量产。

该工厂将专注于建造下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能 (AI) 系统的图形处理器的关键组件。

因搭配美国 AI 芯片巨头英伟达的 AI 处理器的高带宽存储 (HBM) 需求激增，SK 海力士作为 HBM 芯片的主要设计者和生产商，已成为人工智能发展热潮中的关键参与者。

7) 三星、SK 海力士下半年 DRAM 晶圆投片量将回到减产前

市调机构 Omdia 的报告指出，包括三星电子、SK 海力士等韩国存储大厂，在 2024 年下半年 DRAM 存储芯片的晶圆投片量有望回归减产前水准，结束近一年的减产，达到 DRAM 领域业务正常化的目标。

报告显示，三星电子本季开始将单月 DRAM 存储芯片晶圆投片量上调至 60 万片，相较上一季提升 13%。另外，预计三星将于下半年开始进一步上调投片量至单月 66 万片，持平减产前水准。呼应这样的报告，先前有消息指出，三星电子位于华城和平泽的 DRAM 产线，其晶圆投片量正在增加，这些产线正在进行 EUV 曝光设备的技术转换过程。

8) 机构：先进封装推动电镀化学品销售额今年突破 10 亿美元

半导体材料市场信息的咨询公司 TECHCET 预测金属电镀化学品将在 2024 年增长 7%，达到超过 10 亿美元。2023 年这一数字为 9.47 亿美元，相比 2022 年降 6%。综合来看，该市场将迎来一个显著的跃升。

预计 2023 年至 2028 年，这些金属电镀化学品的复合平均增长率预计将超过 5.4%。增长驱动因素包括先进封装的使用增加，例如重新布线层(RDL)和铜柱结构等，以及埋入式电源轨和背面铜布线。

TEHCET 认为，2024 年第一季度半导体器件产量将继续缓慢增长，2024 年下半年，由于众多应用(电动汽车、更多快速充电站)的增长，预计器件需求将会增加，这将推动对金属互连层和更先进封装材料的需求增加。

9) 台积电震后产能恢复至七成以上，损失或达 6200 万美元

集微网消息，在 4 月 3 日中国台湾花莲地区强震之后，台积电声明指出，关键设备 EUV “安全无虞”，在地震 10 小时后产能就恢复到了七成或八成，然而地震及余震仍然对部分生产设施产生影响。供应链指出，此次地震致使生产中断以及造成损失约为 6200 万美元，其中，虽然 EUV 没有损坏，但工厂的横梁、柱子、墙壁和管道在地震中遭到损坏。

2.2 AI 板块

1) 国务院国资委确定首批启航企业，重点布局 AI、量子信息等新兴领域

据国务院国资委消息，近日按照“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。

据悉，此次遴选出的首批启航企业多数成立于 3 年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域，企业核心技术骨干平均年龄 35 岁左右。

据悉，当前国务院国资委正在深入实施产业焕新行动和扎实推进未来产业启航行动，日前还启动了“人工智能+”行动。按照部署，国企央企要力争在人工智能、新能源、新能源汽车等重点领域形成一批标志性成果，加快建设战略性新兴产业集群；加快培育启航企业、领军企业、独角兽企业，在类脑智能、量子信息、深地深海、激光制造等领域突破一批关键技术、形成一批标志性产品；加快数字化转型试点和智能工厂建设，打造更多绿色低碳示范项目。

2) 消息称 OpenAI 将于本月在日本东京设立亚洲首个办事处

IT 之家 4 月 1 日消息，据日经新闻报道，OpenAI 将于本月（2024 年 4 月）在日本东京开设亚洲首个办事处并开始业务活动。除了为企业提供独特的服务外，OpenAI 还将参与制定正确使用生成式 AI 的规则。

2.3 消费电子板块

1) 超预期：Meta 智能眼镜单季发货超 30 万副，多家国内供应商受益

据『AR 圈』调研，Meta 与雷朋（Ray-Ban）联名的第二代智能眼镜在 2023 年第四季度的发货量超 30 万副，远超 Meta 此前预期，舜芯和歌尔等国内供应商或由此受益。

据『AR 圈』调研，Meta 与雷朋（Ray-Ban）联名的第二代智能眼镜在 2023 年第四季度的发货量超 30 万副，远超 Meta 此前预期，舜芯和歌尔等国内供应商或由此受益。

2) 三星将推平价折叠机第 4 季有望亮相 大立光、晶技将受惠

三星新款折叠机最快第 3 季发表，并有望于第 4 季“加码”推出售价低于 1,000 美元的首款平价折叠机，估售价仅 800 美元，为市面上最便宜的折叠机，业界看好有助大幅提高买气，带旺大立光、晶技等供应链。

有媒体报道指出，三星将在 7 月下旬推出两款折叠新机，名为 Galaxy Z Fold 6 与 Galaxy Flip 6，并于 9 月或 10 月推出旗下第一款平价折叠机 Galaxy Z Fold 6 FE。

供应链传出，Galaxy Z Fold 6 FE 搭载标准版规格的摄像配备，但不支持手写笔功能，机身则会比标准版更薄，重量也较轻，粗估初期出货量约 20 万至 30 万支，后续是否追加订单视市场反映而定。

3) 销量猛飙至上代 800% 国内首款 AI 折叠屏手机线上订单已排至月底

4 月 3 日上午，国内首款 AI 大模型折叠屏手机 vivo X Fold3 系列正式开售。新机一经发布便迅速引发了国内外消费者的抢购热情，短短一分钟销量即迅猛飙升至上代 vivo X Fold2 的 800%，销售远超市场预期。

vivo 京东、天猫官方旗舰店数据显示，vivo X Fold3 系列两款机型上线预售即被用户疯抢。目前，线上订单已排队至月底。

作为行业首款的 AI 大模型折叠屏 vivo X Fold3 系列搭载了全新 OriginOS 4，为用户带来了“一句话剪视频”“小 V 帮记”等智慧有趣的便捷体验。还支持手机、平板、网页、Windows、Mac 五端协同，实现跨屏互联和无缝数据流转，轻松实现跨屏办公。

4) 华为“一种分屏显示的方法以及电子设备”专利公布

天眼查显示，华为技术有限公司“一种分屏显示的方法以及电子设备”专利公布，申请公布日为 2024 年 3 月 26 日，申请公布号为 CN117762309A。本申请提供了一种分屏显示的方法以及电子设备，该方法应用于折叠屏电子设备，用户可以在折叠屏电子设备的显示界面向内滑动，折叠屏电子设备可以根据用户的操作进入分屏模式，且可以根据用户的操作确定新增的分屏界面的显示位置，该种操作方式契合用户握持折叠屏电子设备的姿势，用户的操作方式简单，提高了用户体验，且电子设备在分屏显示时充分利用了电子设备的折叠的位置，使得折叠的位置为分屏界线的位置，不需要额外确定分屏界线。

2.4 汽车电子板块

1) 3月汽车销量：比亚迪 30.25 万辆领衔，问界、理想竞争胶着

4月1日，多家新能源汽车企业及头部造车新势力陆续发布3月销量数据：

比亚迪：3月销售新能源汽车 302,459 辆，上年同期为 207,080 辆，今年累计销售新能源汽车 626,263 辆，同比增长 13.44%。

理想汽车：3月交付新车 28,984 辆，同比增长 39.2%。2024 年第一季度共计交付 80,400 辆，同比增长 52.9%。截至 2024 年 3 月 31 日，理想汽车累计交付 713,764 辆，成为首家达成累计交付七十万辆里程碑的中国新势力车企。

蔚来汽车：3月共交付新车 11,866 辆，同比增长 14.3%，环比增长 45.9%。2024 年一季度，蔚来共交付新车 30,053 辆。截至目前，蔚来已累计交付新车 479,647 辆。

哪吒汽车：3月终端销量达 8317 辆，哪吒 L 将于 4 月上市，上市即交付。桐乡工厂正在进行改建扩建工程，对 3 月 4 月的产量会有较大影响，预计 4 月中下旬起将逐步拉动产能，年产能实现 20 万辆。

2) 需求强劲 小米 SU7 买家面临 4-7 个月交货周期

集微网消息，小米提示其 SU7 电动轿车的潜在买家，交付可能要等上 4 到 7 个月，这表明市场对小米首款汽车的需求强劲。小米于 3 月 28 日开始接受订单，并表示在上市 24 小时内预订了 88898 台。

根据媒体对小米汽车应用程序的查询，售价为 21.59 万元的标准 SU7 车型可能需要 18-21 周才能交付。SU7 Pro 车型的交付时间也可能需要 18-21 周，而售价 29.99 万元的车型可能需要 27-30 周。

3) 汽车贷款政策放宽！两部门印发通知

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》（以下简称《通知》），明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。鼓励金融机构结合汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。

4) 滴滴自动驾驶与广汽埃安合资公司获批 2025 年推出首款商业化 L4 车型

4月7日消息，滴滴自动驾驶与广汽埃安宣布合资公司广州安滴科技有限公司获批工商执照。这是 L4 自动驾驶公司和车企为了打造 Robotaxi 量产车，在国内成立的首家合资公司。首款车型已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，计划明年实现量产。

2.5 面板板块

1) 需求回温，预估 2024 年全球 LED 产业营收年增 3%，市场聚焦车用显示战

根据 TrendForce 最新 LED 产业报告显示，2024 年全球 LED 市场将有机会恢复成长，产值预估可达 130 亿美元，年增 3%。主要受惠于车用照明与显示、照明（一

般照明、建筑照明、农业照明)、LED 显示屏、紫外线/红外线 LED 等市场需求有机会逐步回温,以及 Micro LED 技术目前已成功导入至大型显示如三星,以及手表如 Tag Heuer 等因素带动。

2) 机构: 2028 年 Micro LED 市场规模将达 250 亿美元

集微网消息,市调机构 Research And Markets 指出,由于市场对更为明亮的显示解决方案需求增长,预估全球 Micro LED 市值规模在 2028 年将达到 250 亿美元,2023 年至 2028 年的年均复合增长率为 74.5%。

Research And Markets 表示, Micro LED 目前占比最高的应用是大型显示器, Micro LED 未来将在家庭娱乐应用之中扮演关键角色,市场需求可望逐年提高。

Research And Markets 提到, Micro LED 受惠于其体积小、功耗异常低的可能性相对较低,因此最大的增长动力来自于智能手机及可穿戴设备,包括友达以及 LG、三星皆已展开大量投资,研发的产品种类包括笔记本电脑、手机、手表、AR (增强现实) 眼镜等。

3) 机构: 液晶电视面板价格“肯定”在 4 月份继续上涨

中国科技行业洞察提供商洛图科技表示,液晶电视面板价格“肯定”将在 4 月份甚至 5 月份继续上涨。

由于面板制造商控制产能利用率,液晶显示器 (LCD) 面板的价格也有所上涨,全球液晶电视面板供需依然紧张。然而,群智咨询 (Sigmaintell) 表示,市场动态正在发生变化。

4) 2025 年起笔记本电脑将加速采用 OLED 屏幕

据市场消息称,2025 年至 2026 年期间,笔记本电脑中 OLED 显示屏技术的采用将会加速。

拥有 OLED 显示驱动 IC (DDI) 技术的中国台湾 IC 设计公司对此持乐观态度。虽然他们可能面临来自韩国同行的更多竞争,但一般来说, OLED DDI 可以在更多多样化的应用领域进行开发。

除了增加产品出口外,中国台湾 IC 设计企业还可以有效减缓手机面板的集中竞争,从而缓解价格竞争的压力。据市场研究机构 Omdia 预计,2024 年全球笔记本电脑 OLED 出货量将达到 510 万台、2025 年 700 万台、2026 年 1850 万台。

三、 公司动态跟踪

图表 9: 过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量 上限	拟变动数量上限占 总股本比 (%)
300736.SZ	百邦科技	2024-04-03	减持	陈进	董事	320,646	0.25
688391.SH	钜泉科技	2024-04-04	增持	杨士聪	董事长	/	/

603297.SH	永新光学	2024-04-04	减持	加茂资讯技术有限公司	5%以下股东	300,000	0.27
600666.SH	ST 瑞德	2024-04-03	减持	共青城元通创业投资合伙企业	5%以上非第一大股东	27,630,000	1.00
300576.SZ	容大感光	2024-04-02	减持	魏志均	监事	1,000,000	0.41
300576.SZ	容大感光	2024-04-02	减持	蔡启上	董事	116,950	0.05
300576.SZ	容大感光	2024-04-02	减持	牛国春	董事	1,189,873	0.48
300576.SZ	容大感光	2024-04-02	减持	曾大庆	财务总监	13,290	0.01
605277.SH	新亚电子	2024-04-02	减持	海南历信创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	2,644,919	1.00
688536.SH	思瑞浦	2024-04-04	减持	苏州金樱创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	397,800	0.30
835179.BJ	凯德石英	2024-04-04	增持	陈强	董事	/	/
835179.BJ	凯德石英	2024-04-04	增持	张忠恕	实际控制人	/	/
835179.BJ	凯德石英	2024-04-04	增持	周文	高级管理人员	/	/
835179.BJ	凯德石英	2024-04-04	增持	南舒宇	高级管理人员	/	/
835179.BJ	凯德石英	2024-04-04	增持	张娟	高级管理人员	/	/
300223.SZ	北京君正	2024-04-03	减持	张紧	董事兼副总经理	1,000,000	0.21
300223.SZ	北京君正	2024-04-03	减持	张燕祥	监事会主席	80,000	0.02
300223.SZ	北京君正	2024-04-03	减持	张敏	副总经理兼董秘	250,000	0.05
300223.SZ	北京君正	2024-04-03	减持	沈永辉	董事兼副总经理	1,500,000	0.31

数据来源: Wind, 华福证券研究所

图表 10: 过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当时总 股本比例(%)	期权初始行 权价格
688035.SH	德邦科技	2024-04-02	董事会预案	上市公司定向发行股票及 上市公司提取激励基金买 入流通股	640.00	4.4994	24.45
688508.SH	芯朋微	2024-04-03	董事会预案	上市公司定向发行股票及 上市公司提取激励基金买 入流通股	675.00	5.1405	33.14
688361.SH	中科飞测-U	2024-04-02	实施	上市公司定向发行股票	800.00	2.5000	30.69
688045.SH	必易微	2024-04-04	实施	上市公司定向发行股票	307.05	4.4468	15.00
688361.SH	中科飞测-U	2024-04-02	实施	上市公司定向发行股票	800.00	2.5000	30.69
688766.SH	普冉股份	2024-04-02	实施	上市公司定向发行股票及 上市公司提取激励基金买 入流通股	43.19	0.5719	46.32

数据来源: Wind, 华福证券研究所

四、 风险提示

技术发展及落地不及预期; 下游终端出货不及预期; 下游需求不及预期; 市场竞争加剧风险; 地缘政治风险; 电子行业景气复苏不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn